

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB I PENDAHULUAN	2
I.1 Latar Belakang	2
I.2 Rumusan Masalah	7
I.3 Tujuan Penelitian.....	7
I.4 Manfaat Penelitian.....	7
I.5 Batasan Penelitian	8
I.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
II.1 Kajian Pustaka	10
II.1.1 <i>Maintenance</i>	10
II.1.2 Reliability	11
II.1.3 Kurva Laju Kerusakan (<i>Failure Pattern</i>)	12
II.1.4 Mean Time Between Failure (MTBF)	12
II.1.5 Mean Time to Repair (MTTR)	14
II.1.6 <i>System Breakdown Structure</i>	14
II.1.7 <i>Spare part management (SPM)</i>	15
II.1.8 Tujuan <i>Spare part Management (SPM)</i>	15
II.1.9 <i>Spare part</i>	15
II.1.10 <i>Reliability Centered Spares (RCS)</i>	15
II.1.11 <i>Risk Matrix</i>	17
II.1.12 <i>Poisson Process</i>	19
II.1.13 Perhitungan Komponen <i>Repairable</i>	20
II.1.14 <i>Inventory Analisis</i>	21
II.1.14.1 <i>EOQ Modification</i>	23
II.2 Jurnal Terkait	26
II.3 Penelitian Terkait	28

II.4 Pemilihan Metode	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
III. 1 Model konseptual.....	29
III.2 Sistematika Penyelesaian Masalah	31
III.2.1 Tahap Pendahuluan.....	33
III.2.2 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan data.....	34
III.2.3 Analisis dan Kesimpulan.....	36
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	37
IV.1 Pengumpulan Data.....	37
IV.1.1 Deskripsi Perangkat Akses.....	37
IV.1.2 Kegiatan Perawatan Subsistem GPON.....	38
IV.1.3 Data Failure	38
IV.1.4 Pemilihan Subsistem Kritis	38
IV.2 Pengklasifikasian Komponen Kritis	40
IV.3 Penentuan Distribusi <i>Time to Repair</i> (TTR)	40
IV.4 Pengelompokan Distribusi <i>Time to Repair</i> (TTR)	41
IV.5 Penentuan <i>Mean Time to Repair</i> (MTTR)	42
IV.6 Penentuan Distribusi <i>Time Between Failure</i> (TBF)	42
IV.7 Penentuan Distribusi <i>Time Between Failure</i> (TBF)	43
IV.8 Penentuan Mean Time Between Failure (MTBF)	43
IV.9 Perhitungan Jumlah kebutuhan <i>spare part</i>	44
IV.9.1 Perhitungan komponen <i>Repairable Fanbox C220</i>	45
IV.9.2 Perhitungan komponen Repairable EI8E (Electrical Interface Card)..	52
IV.9.3 Perhitungan komponen Repairable GPU A GPON <i>Uplink Card</i>	59
IV.10 Jumlah komponen kritis yang dibutuhkan dalam waktu 1 tahun	65
IV.11 Perhitungan lot size pemesanan komponen	66
IV. 11.1 Perhitungan besarnya lot size untuk komponen <i>Fanbox C220</i>	66
IV.11.2 Perhitungan lot size untuk komponen <i>EI8E</i>	68
IV.11.3 Perhitungan lot size untuk komponen GPU A GPON <i>Uplink Card</i> ..	70
IV.12 Hasil perhitungan modifikasi EOQ, <i>safety stock</i> dan <i>re-order point</i>	71
BAB V ANALISIS DATA.....	72
V.1 Analisis Penentuan Komponen Kritis	72
V.2 Analisis Pengklasifikasian Komponen.....	72
V.3 Analisis Penentuan Distribusi TBF dan TTR Subsistem Kritis	72
V.4 Analisis Jumlah Kebutuhan <i>Spare part</i>	73
V.5 Analisis Kebijakan <i>Inventory</i>	74

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
VI.1 Kesimpulan	76
VI.2 Saran	77
VI.2.1 Saran Bagi Perusahaan.....	77
VI.2.2 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	80